

☆30年以上CMPに携わってきた講師が、装置、材料、プロセスなどの基礎から最新動向を徹底解説します！

最新CMP技術 徹底解説【LIVE・アーカイブ】

<https://www.rdsc.co.jp/seminar/250998>

◆日 時：2025年09月24日（水） 10:30～16:30

【アーカイブ配信：9/25～10/2】

◆会 場：WEBセミナー（オンライン開催）

◆聴講料：1名につき55,000円（税込、資料付）

※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申込みされた場合、1名につき49,500円（税込）

・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料（2名で55,000円（税込））

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：(株)ISTL 代表取締役社長 博士(工学) 礒部 晶 氏

【講座の趣旨】

CMPという当初ゲテモノ扱いされていたプロセスが半導体製造に導入されて四半世紀以上が経過した。いまではなくてはならないキープロセスとなっており、その工程数、応用範囲はますます広がっている。最新のFinFET等のトランジスタ工程や3D NANDに用いられる工程を初めとして、適用工程毎の特徴を紹介し、用いられる装置、材料について解説する。さらに、平坦化のメカニズムや材料除去のメカニズムについてもモデルを紹介する。

【プログラム】

1. 最新デバイス動向とCMP

- 1-1 AIとIoT
- 1-2 トランジスタ構造の変遷
- 1-3 メモリデバイスの分類と動向
- 1-4 パッケージ技術への応用
- 1-5 最近のCMP関連学会における注目トピックス

2. CMP装置

- 2-1 半導体の製造方法とCMPの歴史
- 2-2 CMP装置の構成
- 2-3 ヘッド構造
- 2-4 終点検出技術
- 2-5 APC

3. CMPによる平坦化

- 3-1 CMPによる平坦化工程の分類
- 3-2 平坦化のメカニズム

4. CMP消耗材料

- 4-1 各種スラリーの基礎
- 4-2 砥粒の変遷
- 4-3 添加剤の役割
- 4-4 スラリーの評価方法
- 4-5 研磨パッドの基礎
- 4-6 研磨パッドの評価方法
- 4-7 コンディショナーの役割

5. CMPの応用

- 5-1 CuCMPの詳細
- 5-2 最新のトランジスタCMP工程
- 5-3 各種基板CMP
- 5-4 CMPのプロセス評価方法

6. CMPの材料除去メカニズム

- 6-1 研磨メカニズムモデルの歴史
- 6-2 新しいモデル～Ferret径モデル
- 6-3 Ferret径モデルの数値検証
- 6-4 Ferret径モデルに基づく開発のヒント

7. まとめ

「CMP」セミナー申込書

■LIVE

■アーカイブ

※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい

会社・大学			
住 所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録（無料） ※案内方法を選択してください。複数選択可。

☐Eメール☐郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>